



EP 1 863 329 B8

(12)

KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 84

(51) Int Cl.:
H05K 9/00 (2006.01) **H02G 3/22 (2006.01)**

(48) Corrigendum ausgegeben am:
09.09.2009 Patentblatt 2009/37

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
29.07.2009 Patentblatt 2009/31

(21) Anmeldenummer: **07010172.0**

(22) Anmeldetag: **22.05.2007**

(54) EMV-Abdichtung

EMC insulation

Etanchéification électromagnétique

(84) Benannte Vertragsstaaten:
FR GB

(30) Priorität: **01.06.2006 DE 102006025674**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.12.2007 Patentblatt 2007/49

(73) Patentinhaber: **Fujitsu Siemens Computers GmbH**
80807 München (DE)

(72) Erfinder: **Neukam, Wilhelm**
86399 Bobingen (DE)

(74) Vertreter: **Epping - Hermann - Fischer**
Patentanwaltsgeellschaft mbH
Ridlerstrasse 55
80339 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
WO-A-03/034800 **DE-U1- 29 620 388**
US-A- 6 119 305 **US-A1- 2003 127 853**
US-B1- 6 320 122

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).